

# Denseo HiQ-Bonder®: Instrucciones de uso



### Limpieza a Vapor

Limpiar la estructura de circonio sinterizado con vapor y dejarla secar. Recomendamos: No chorree la estructura antes de aplicar el



#### Aplicación HiQ-Bonder

Use un pincel para opaquer limpio y aplique una capa uniforme del HiQ-Bonder.



#### Cocción

Dependiendo del horno, los resultados pueden variar. El HiQ-Bonder debe mostrar una alta translucidez y un alto brillo después de la cocción.

Por favor, siga la tabla de cocción.



# **Chorrear Ligeramente**

Para lograr una unión óptima entre la estructura de circonio y el recubrimiento de cerámica, le aconsejamos chorrear ligeramente la estructura con óxido de aluminio de 50 micras a 1 bar. Posteriormente la superficie debe tener una aspecto mate uniforme.



# Limpieza a Vapor

Limpiar la estructura de circonio con vapor y dejarla secar bien. Evite cualquier contaminación con grasa por tocar la estructura con los dedos.



#### Recubrimiento

Seguir recomendación de fábrica.

## Tabla de cocción

bonder

Temperatura inicial: 500° C
Secar antes durante: 4 minutos
Incremento de temperatura: 65° C
Temperatura Final: 1050° C
Tiempo de Espera: 1 minuto
Vacio Inicio: 500° C
Vacio Final: 1050° C

# Importante:

Las temperaturas de cocción son aproximadas. Puede haber diferencias entre distintos hornos y si es necesario deberían ser ajustadas.

